

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	易方达基金、平安基金、华泰资产、景顺长城基金、信达澳亚基金、长城基金、光大保德信基金、广发基金、人保养老、华安基金、合众资产、国联基金、创金合信基金、宏利基金、摩根士丹利基金、长信基金、全天候基金、东吴基金、申万宏源证券、中邮证券、银河证券、浙商证券、长江证券
时间	2026年5月6日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、关于第一季度业绩的说明</p> <p>2026年第一季度，公司实现营业收入约1.12亿元，较上年同期增长6.22%，主要系公司大直径硅材料业务境外收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润约2,539万元，较上年同期减少10.96%，主要系公司增加研发投入及期间费用有所增加所致。</p> <p>二、关于公司主营业务毛利率的说明</p> <p>2026年第一季度，公司整体毛利率变化的主要影响因素为硅片业务的开工率提高。</p> <p>当前，8英寸轻掺硅片市场的竞争格局出现有利变化，国产化窗口打开，公司将审慎投入；公司还将继续深化对相对高毛利的利基型硅片需求的探索和培育。</p> <p>随着大直径硅材料业务进入景气区间，硅零部件业务客户结构持续改善，公司整体毛利率存在提升空间。</p>

三、公司的产能扩充战略

2026年第一季度，全球消费级存储需求转向中国供应链的趋势明朗，中国本土存储芯片制造厂商的产能扩充和技术发展，在科技巨头资本开支所驱动的人工智能需求之外，获得了全球消费市场更为坚实、持久的支撑。

公司认为，中国本土厂商以超大规模国内统一大市场为基础，通过“规模降本-技术迭代-产业链闭环-建立行业标准”的路径，后发先至取得全球产业竞争制高点之范式，在过去十年的LCD面板、光伏、动力电池、碳纤维等领域得到反复验证。因此，中国本土存储芯片制造厂商有望加速成长为世界级公司。

相比海外竞争对手数十年乃至上百年的积累而言，包括公司在内的本土半导体材料和零部件企业，普遍设立时间较短、经验有限、资源不足。如何在短时间内匹配世界级客户的世界级需求？既是挑战更是机遇。这对所有中国国产厂商的生产管理、供应链建设、智能化管理水平、资本运作能力乃至企业文化建设，提出了全方位的跃升要求。用进废退，不进则退，产业竞争已经从“资格赛”和“小组赛”，进入到“排位赛”和“淘汰赛”。

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元人民币。公司将稳扎稳打，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国产化率提升的机遇。

四、公司对潜在地缘政治事件的影响评估

公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。

当前，中国本土半导体材料和零部件产业仍处于起步阶段，地缘政治事件对供应链的潜在影响既是挑战更是机遇。

公司将密切关注事态发展，提前筹划供应链寻源和国产化工作，加强库存管理，争取在未来的国产化浪潮中取得佳绩。

	<p style="text-align: center;">五、公司对2026年半导体市场的展望</p> <p>展望后续经营，公司将积极把握半导体市场特别是存储芯片市场境内外“同频共振”的历史机遇，计划实现大直径硅材料业务境外市场的收入突破，保质保量完成硅零部件业务的产能扩充并持续优化客户结构。公司还将密切研判当前地缘政治经济宏观事件频发态势下的国际半导体供应链重组动向，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验 and 资源，为股东创造价值。</p>
附件清单	无
日期	2026年5月8日